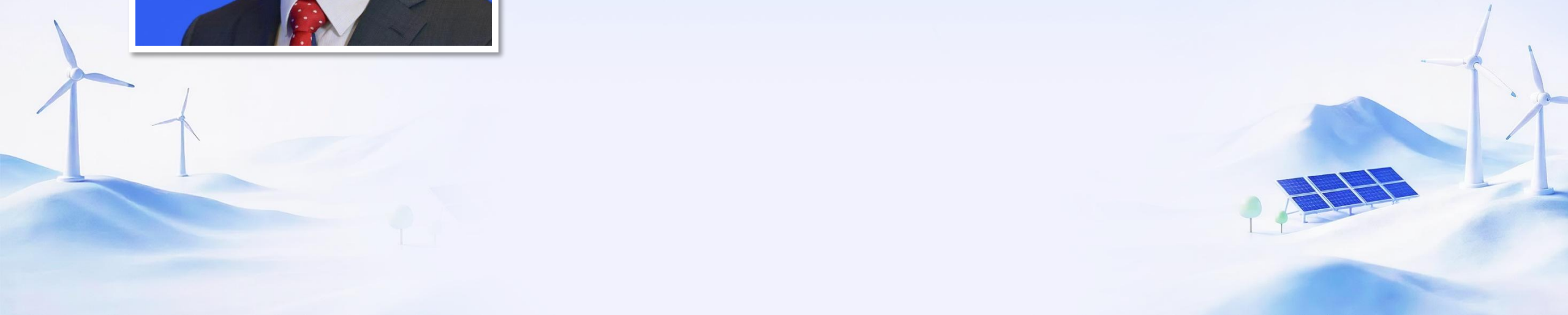




OPEN NPO项目介绍&启动仪式

张广彬

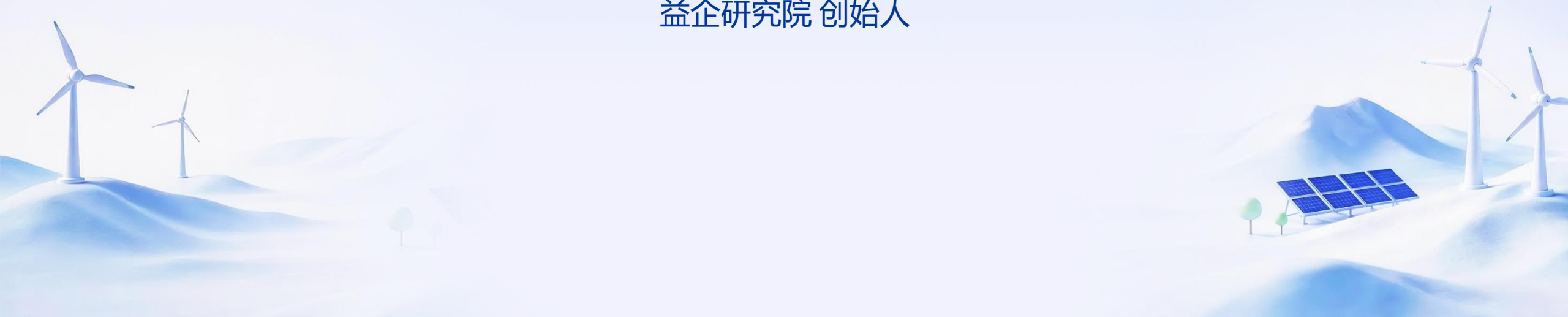
Open AI Infra 社区秘书长
益企研究院 创始人



OPEN NPO项目介绍 & 启动仪式

张广彬

Open AI Infra 社区秘书长
益企研究院 创始人



Scale up高速互连面临物理极限挑战，NPO光互连成为重要选择



电互连：物理瓶颈日益凸显



NPO成为Scale up光互连当前优选方案



趋肤效应导致线径增大

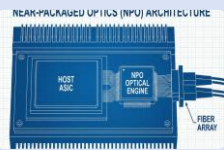
无源铜缆传输距离 < 3m@800G。

阻挡机柜风道，冷却与传输能耗急剧上升，带来散热与功耗挑战

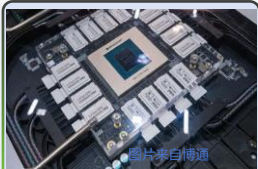
突破方向



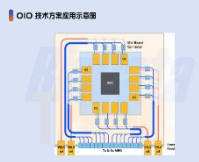
可插拔光模块
(Pluggables)



近封装光学
(NPO)



共封装光学
(CPO)



光输入/输出
(OIO)

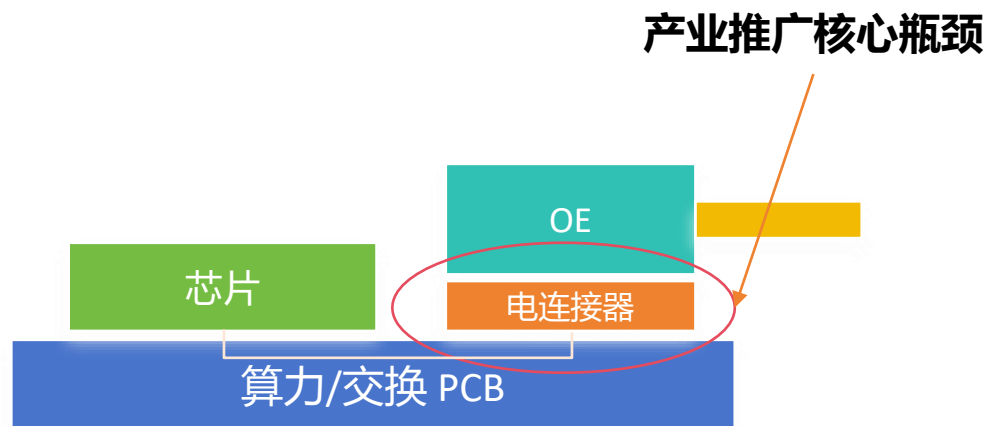
导入

为何NPO是当前最优解？

- 性能与成本的最佳平衡点
- 可维护性
- 供应链成熟度

OPEN NPO项目范围

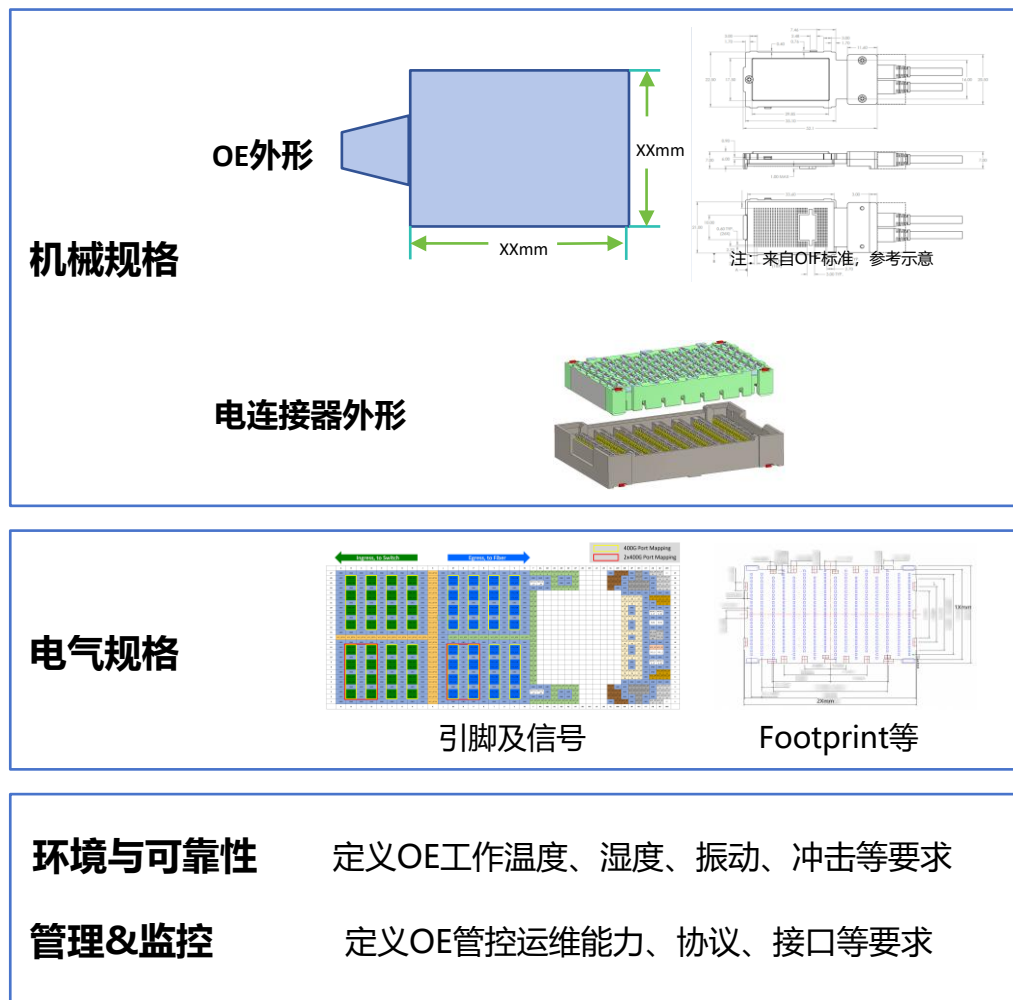
电连接器成为NPO核心瓶颈



电连接器不统一的影响:

- 影响算力/交换模组设计
- 影响OE设计
- 影响算力/交换模组与OE多厂家互配, 影响产业规模应用

7.2T/6.4T 规范主要范围



OPEN NPO项目里程碑

6月4日 项目筹备会

6月26日 立项，7月3日 启动

26年Q3 规范发布&样品测试

序号	议题
议题一	开场致辞
议题二	超节点光互连技术演进
议题三	NPO光引擎技术方案研讨
议题四	AI时代-新型光互联技术的演进与挑战
议题五	Introduction of 14.4Tb/s NPO Module Connector
议题六	NPO for AI Cluster Applications and Molex Proposals
议题七	高可靠小间距Tbps NPO Socket
议题八	NPO用光电芯片设计之思考-光电合封 赋能AI
议题九	特色工艺先进封装 赋能AIDC光互联
议题十	OAII NPO项目介绍&全员讨论



围绕超节点光互连方案研讨；
达成共建NPO规范产业共识。

参与单位

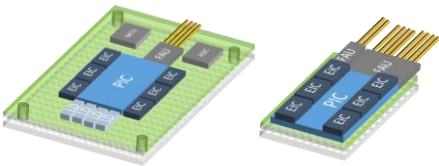
- 用户：抖音、京东、阿里等
- 算力/交换：华为、中兴、盛科、锐捷、摩尔线程、新华三、澜起科技、华鲲振宇、超聚变、博通、壁仞、畅快算、海光、澜起科技、软通计算机、英业达、远图未来、至索等
- OE：光迅、华工正源、纳真科技、曦智科技等
- 电连接器：华丰科技、山一、广濑、molex、立讯、庆虹、安费诺等
- 光电芯片及其他：傲科、中航光电、万里眼、胜蓝科技、灵达科技、空间浮点、新微科技、集益微等

50+单位筹备研讨

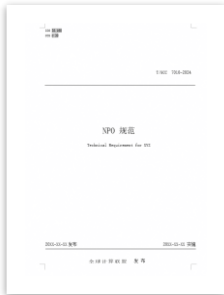


20+首批发起单位

OE样品



7.2T/6.4T 规范



规范发布，样品邀测

Thank You

